

《CSP技術PART II:高密度IC貳

图书基本信息

书名：《CSP技術PART II:高密度IC封裝》

13位ISBN编号：9789578173859

10位ISBN编号：9578173857

出版时间：2000年04月01日

出版社：建興

作者：萩本英二

译者：陳連春

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介以及在线试读，请支持正版图书。

更多资源请访问：www.tushu000.com

《CSP技術PART II:高密度IC貳

內容概要

內容簡介 CSP技術目前已成為盛行的技術，其技術進步比預期的還早。但是，從另一個觀點來看，此一CSP/BGA的變化並非只是單純的半導體PKG一領域之變化，而是與半導體的高性能化有關。CSP具有FC的優點，技術上有很多共通之處。與FC從晶圓製造工程導入新的工程比較，CSP有各種變化，其投資有些並不像傳統的FC那麼大，因此，目前可以說是各種CSP進化的過程時期。本書對於個別的技术並沒有做很詳細的說明，而是儘量以全體的觀點來說明。希望讀者能夠與筆者一起鳥瞰半導體產業生意之全貌。

《CSP技術PART II:高密度IC貳

書籍目錄

1 . F C / C S P 製造技術與其構造 2 . 高密度裝配 3 . 高密度裝配基板 4 . F C / C S P 之信賴性 5 . 標準化 6 . 測試技術 7 . 新的產業基本設施之創造

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:www.tushu000.com